

智慧物聯網晶片化整合服務計畫(lisC)

適用對象 | 不限，建議為國內外新創與中小企業

服務內容 |

lisC 幫助廠商創意落實，縮短產品開發歷程/加速商品化，促進更多潛力產品投入智慧創新應用

技術服務

01

幫您解決IoT產品硬體設計或製造所面臨的疑難雜症，提供產品優化之技術諮詢服務

應用方案

02

可建議產品開發團隊選用最合適的IC應用方案，並提供相關技術支援與小量試產服務

產品試煉

03

媒合產品進入商業化場域試煉，整合意見貼近市場需求或取得關鍵數據與建模，建立Edge AI精準智慧化服務

提升終端產品價值

- 低功耗無線網路
- 微縮化封裝
- AI邊緣運算
- AI嵌入演算法
- IP/IC設計
- 國產晶片方案
- 資安解決方案
- 高規實證

